

# 2018-2024年中国驱动IC 用COF市场深度研究与产业竞争格局报告

## 报告目录及图表目录

智研数据研究中心 编制

[www.abaogao.com](http://www.abaogao.com)

# 一、报告报价

《2018-2024年中国驱动IC用COF市场深度研究与产业竞争格局报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.abaogao.com/b/ruanjian/Z22719IHA2.html>

报告价格：印刷版：RMB 9800 电子版：RMB 9800 印刷版+电子版：RMB 10000

智研数据研究中心

订购电话：400-600-8596(免长话费) 010-80993963

海外报告销售：010-80993963

传真：010-60343813

Email：sales@abaogao.com

联系人：刘老师 谭老师 陈老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、说明、目录、图表目录

报告目录：

### 第一章 COF产品概述

#### 第一节 COF的定义

#### 第二节 COF品种

#### 第三节 COF——目前的主流挠性IC封装形式

##### 一、IC封装

##### 二、IC封装基板与常规印制电路板在性能、功能上的差异

##### 三、IC封装基板的种类

#### 第四节 COF与TAB、TCP、TAPE BGA/CSP在定义上的区别

#### 第五节 COF在驱动IC中的应用

#### 第六节 COF行业与市场发展概述

### 第二章 COF的结构及其特性

#### 第一节 COF的结构特点

#### 第二节 COF在LCD驱动IC应用中的特性

#### 第三节 COF与其它IC驱动IC封装形式的应用特性对比

##### 一、COF与COG比较

##### 二、COF与TAB比较

#### 第四节 未来COF在结构及其特性上的发展前景

##### 一、制作线宽/线距小于 $30\mu\text{m}$ 的精细线路封装基板

##### 二、卷式（ROLL TO ROLL）生产方式的发展

##### 三、多芯片组装（MCM）形式的COF

#### 第五节 COF的更高阶封装形式——基于挠性基板的3D封装的发展

##### 一、从2D发展到3D的挠性基板封装

##### 二、基于挠性基板的3D封装的主要形式

### 第三章 驱动IC产业现状与发展

#### 第一节 驱动IC的功能与结构

##### 一、驱动IC的功能及与COF的关系

##### 1、驱动IC的功能

## 2、驱动IC与COF的关系

### 二、驱动IC的结构

### 三、驱动IC的品种

#### 第二节 驱动IC在发展LCD中具有重要的地位

#### 第三节 大尺寸TFT-LCD驱动及其特点

##### 一、大尺寸TFT-LCD驱动特点

##### 二、大尺寸TFT-LCD驱动芯片设计难点

#### 第四节 驱动IC产业的特点

#### 第五节 世界显示驱动IC的市场现况

##### 一、显示驱动IC制造厂商与下游LCD面板厂家的关系及分析

##### 二、世界显示驱动IC设计业现况

##### 三、世界显示驱动IC市场规模调查统计

#### 第六节 世界显示驱动IC主要生产厂家的现况

## 第四章 液晶面板应用市场现状与发展

### 第一节 世界液晶面板市场规模与生产情况概述

#### 一、世界液晶面板市场变化

#### 二、世界面板市场品种的格局

#### 三、台、中、日、韩面板产业发展及趋势分析

### 第二节 世界大尺寸TFT-LCD应用市场发展现况

#### 一、世界大尺寸面板市场规模总述

#### 二、液晶电视领域对大尺寸面板的需求情况

#### 三、平板电脑领域对大尺寸面板的需求情况

#### 四、显示器领域对大尺寸面板的需求情况

#### 五、对2017年世界大尺寸面板市场需求的预测

### 第三节 我国液晶面板市场规模与生产情况概述

#### 一、我国驱动IC设计行业的情况

#### 二、我国液晶面板产业的发展

#### 三、我国液晶面板生产现况与未来几年发展预测

## 第五章 COF的生产工艺及技术的发展

### 第一节 COF制造技术总述

## 一、COF的问世

## 二、COF的技术构成

### 第二节 COF挠性基板的生产工艺技术

#### 一、COF挠性基板生产的工艺过程总述及工艺特点

#### 二、挠性基板材料的选择

#### 三、精细线路的制作

### 第三节 IC芯片的安装技术

### 第四节 COF挠性基板的主要性能指标

## 第六章 世界COF基板的生产现状

### 第一节 全世界COF基板生产量统计

### 第二节 全世界COF市场格局

### 第三节 全世界COF基板主要生产厂家

### 第四节 全世界COF基板主要生产情况

#### 一、日本COF基板厂家

#### 二、韩国COF基板厂家

##### 1、韩国LG MICRON

##### 2、韩国STEMCO

#### 三、台湾COF基板厂家

##### 1、台湾欣邦

##### 2、台湾易华

## 第七章 我国COF基板的生产现状

### 第一节 我国FPC业的现状

### 第二节 我国COF的生产现况

### 第三节 我国COF基板的生产企业现况

#### 一、国内COF基板生产企业发展概述

#### 二、深圳丹邦科技股份有限公司

##### 1、企业概况

##### 2、COF相关产业发展概况

##### 3、企业经营情况

##### 4、核心优势及发展战略

### 三、三德冠精密电路科技有限公司

- 1、企业概况
- 2、COF相关产业发展概况
- 3、企业经营情况
- 4、核心优势及发展战略

### 四、上达电子（深圳）股份有限公司

- 1、企业概况
- 2、COF产业发展概况
- 3、企业经营情况
- 4、核心优势及发展战略

### 五、厦门弘信电子科技股份有限公司

- 1、企业概况
- 2、COF产业发展概况
- 3、企业经营情况
- 4、核心优势及发展战略

## 第八章 COF挠性基板用二层型挠性覆铜板特性与生产现状（ZY ZM）

### 第一节 二层型挠性覆铜板品种及特性

### 第二节 挠性覆铜板产品主要采用的标准及性能要求

#### 一、适用于FCCL的中国国家标准介绍

#### 二、国际上广泛使用的FCCL标准介绍

- 1、IPC标准
- 2、IEC标准
- 3、日本标准
- 4、测试方法比较

#### 三、实际产品应用中的性能要求

### 第三节 挠性覆铜板的生产工艺

#### 一、三层型挠性覆铜板的生产工艺

- 1、片状制造法
- 2、卷状制造法

#### 二、二层型挠性覆铜板的生产工艺

- 1、涂布法（CASTING）

## 2、层压法 ( LAMINATION )

## 3、溅镀法 ( SPUTTERING/PLATING )

### 第四节 世界挠性覆铜板生产现状及主要生产厂家

#### 一、总述

#### 二、日本FCCL业生产现状与发展

#### 三、美国、欧洲FCCL业的现状与发展

#### 四、台湾FCCL业的现状与发展

#### 五、韩国FCCL业的现状与发展

### 第五节 我国国内挠性覆铜板生产现状及主要生产厂家

#### 一、我国国内挠性覆铜板业发展总述

#### 二、我国国内挠性覆铜板生产厂家现况

#### 图表目录：

图表 1：三种封装基板的CTE及对CCL的CTE要求

图表 2：COF与COG比较分析

图表 3：COF与TAB比较分析

图表 4：2015-2017年世界显示驱动IC市场规模调查统计

图表 5：世界显示驱动IC主要生产厂家的分析

图表 6：2015-2017年全球主流面板厂商分区域销售额走势（单位：十亿美元）

图表 7：2015-2017年全球大尺寸面板出货数量及同比走势（单位：百万台，%）

图表 8：2015-2017年全球大尺寸面板分应用平均尺寸走势（单位：英寸）

图表 9：2018-2024年年全球液晶电视面板平均尺寸走势（单位：英寸）

图表 10：2018-2024年全球液晶电视面板分分辨率占比走势（%）

图表 11：2018-2024年全球分世代线面板产能（ $\geq$ G7）走势（ $Km^2$ ，%）

图表 12：2018-2024年全球智能手机用AMOLED产能增长趋势（刚性+柔性）

图表 13：全球AMOLED和LCD智能手机面板渗透率走势图

图表 14：四地面板企业数量变化图

图表 15：2015-2017年全球液晶面板出货量市占率走势

图表 16：2016H1全球电视面板出货量（百万片）

图表 17：四地液晶面板产能统计及预测（亿平方米）

图表 18：大陆OLED产能建设情况

图表 19：日韩台厂OLED产能建设情况

图表 20 : 2015-2017年全球大尺寸面板出货量统计分析

图表 21 : 2016-2017年全球大尺寸面板出货量

图表 22 : 2015-2017年液晶电视领域大尺寸面板需求量分析

图表 23 : 2015-2017年全球平板电脑领域对大尺寸面板需求量分析

图表 24 : 2015-2017年显示器领域对大尺寸面板需求量分析

图表 25 : 中国崛起为全球LCD产业第三极

图表 26 : COF封装技术工艺流程

图表 27 : 2015-2017年全球COF基板产量统计分析

图表 28 : FPC相比PCB的优点

图表 29 : FPC各类产品特点对比分析

图表 30 : FPC应用领域

详细请访问 : <http://www.abaogao.com/b/ruanjian/Z22719IHA2.html>